

2017年3月期 連結業績見通し及び 中期経営方針について

代表取締役社長
上釜 健宏

2017年3月期 連結業績見通し

2017年3月期 連結業績及び配当金見通し

(億円)		2016年3月期 通期実績	2017年3月期 業績予想	業績予想対前期比	
				増減	増減率(%)
売上高		11,523	11,600	77	0.7%
営業利益		934	740	△ 194	-20.8%
営業利益率		8.1%	6.4%	-1.6 pt	-
税引前利益		918	730	△ 188	-20.5%
当期純利益		648	500	△ 148	-22.8%
1株当たり利益(円)		514.23	396.00	-	-
配当金		上期：60円 下期：60円 年間：120円	上期：60円 下期：60円 年間：120円	-	-
為替	対ドルレート	120.13	110.00	-	-
	対ユーロレート	132.67	125.00	-	-
固定資産の取得 (設備投資)		1,607	2,000	393	24.5%
減価償却費		832	950	118	14.2%
研究開発費		849	900	51	6.0%

2017年3月期 通期連結売上高増減イメージ

(億円)

セグメント 区分	2016年3月期 通期実績	2017年3月期 通期予想 (対前年比)
受動部品	5,757	+3~+6%
磁気応用製品	3,153	-11~-14%
フィルム 応用製品	2,224	+12~+15%
その他	388	-
合計	11,523	11,600

為替前提

為替レート \$/Yen
為替レート EURO/Yen

120.13
132.67

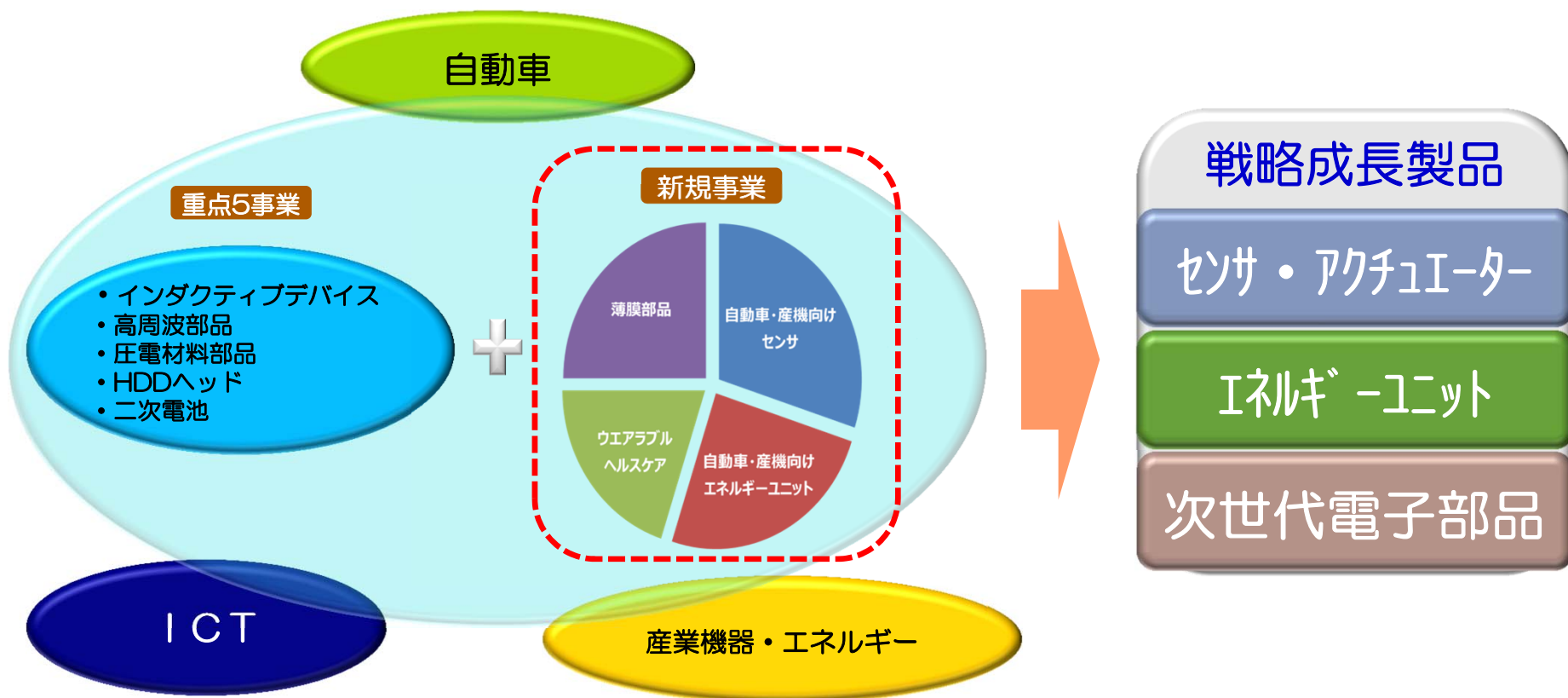
110.00
125.00

2017年3月期 のポイント

セグメント	主要事業の見通し
受動部品	・ インダクタ：ICT、車載市場向け薄膜製品、積層製品のシェア拡大 ・ 高周波部品：小型・高特性ディスクリット品やモジュールの販売拡大 ・ 圧電材料部品：OISビジネスの拡大（中国スマホ搭載率増）
磁気応用製品	・ HDDヘッド： PC需要減少とSSD化加速によるHDD市場台数縮小 16/3期 約4.44億台 ⇒ 17/3期 約4.0億台（10%減） ・ センサ：車載市場向けセンサの拡大、ミクロナスの寄与
フィルム 応用製品 （二次電池）	・ 二次電池：モバイル機器薄型化によるポリマー電池需要の拡大継続 新規アプリケーション需要の拡大 ・ 需要に見合った生産拡大投資及び合理化投資の継続

中期経営方針

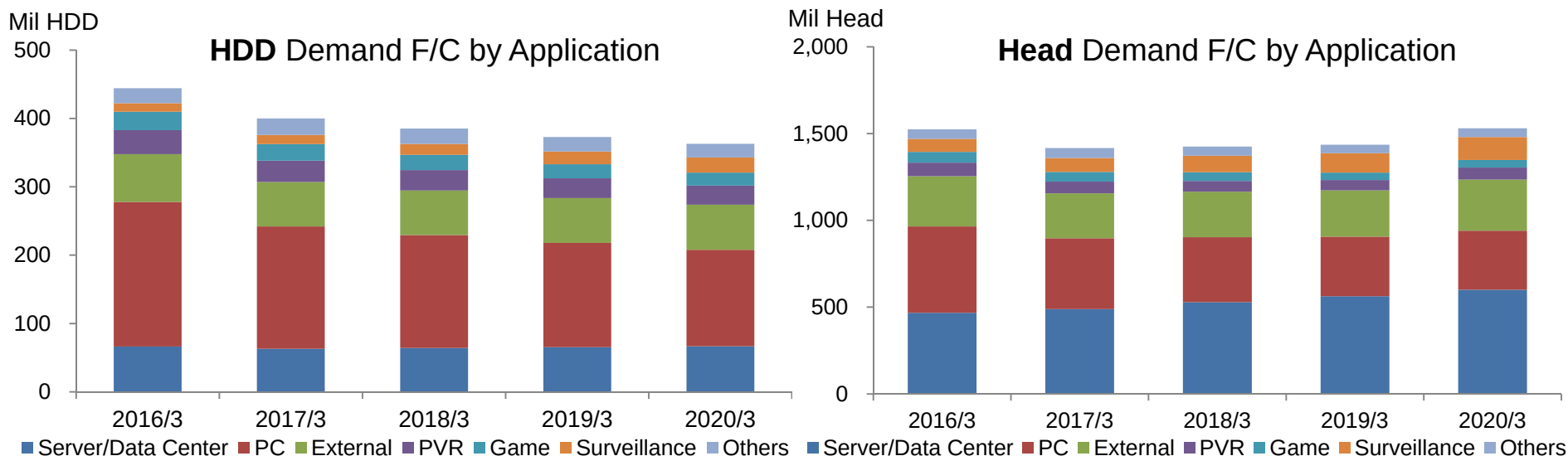
中期重点事業と戦略成長製品



2015/3通期決算説明会(2015/4/28)

記録デバイス事業(HDD ヘッド)について

◆HDD市場/HDD ヘッド需要動向 (2016/3~2020/3)



- HDD市場の縮小傾向継続
(16/3 期4.44億台→20/3期3.63億台)
- PC市場の縮小及びPCのSSD化の加速
- 高速処理用ハイエンドHDDもSSDへの代替が加速
- ニアライン、外付け、監視カメラ向けHDD需要は、堅調に推移

(当社推定)

- HDD市場は縮小もHDDヘッド需要は横這いで推移
- PC用HDDヘッド需要は縮小継続
- ニアライン用HDDヘッドを中心にHDD1台当たりの搭載本数が増加
(16/3期：3.43本→20/3期：4.22本)

(当社推定)

記録デバイス事業(HDD ヘッド)について

自社のライトサイジング実施と業界ライトサイジングへの貢献

①自社のライトサイジング

- 前工程拠点 : 2拠点→1拠点に集約
- 後工程拠点 : 中国の体制リストラ、フィリピンでの受動部品生産の開始

②業界ライトサイジングへの貢献

- Non-captive : 従来の枠組みを超えた開発・製造の垂直的協業の強化
- Captive : 重複投資やコスト増を回避する水平分業
Time-To-Marketを支援する先端技術開発支援

③先端技術力による製品・サービスの提供

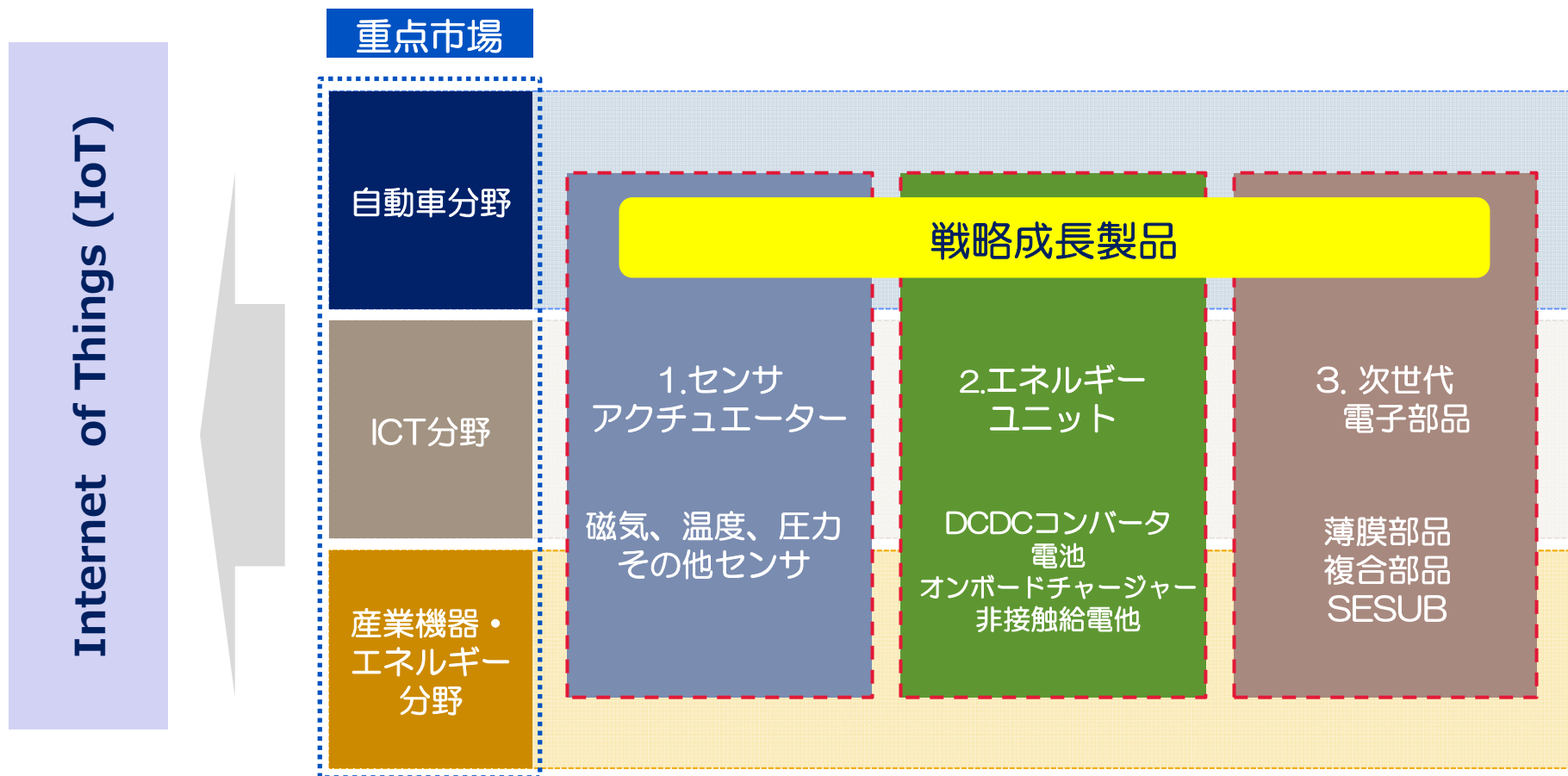
- 熱アシストヘッド(TAMR: 前工程及び後工程)、二次元記録(TDMR)、マイクロDSAの実現
- 後工程技術力によるサービス提供



縮小する市場で “必要とされる存在” であり続ける。

当社の成長戦略（IoT市場へ向けた戦略成長製品）

Qualcomm社との協業体制強化によって戦略成長製品の拡大を加速
⇒重点市場を通してIoT市場における事業機会獲得



Qualcommとの協業体制の強化

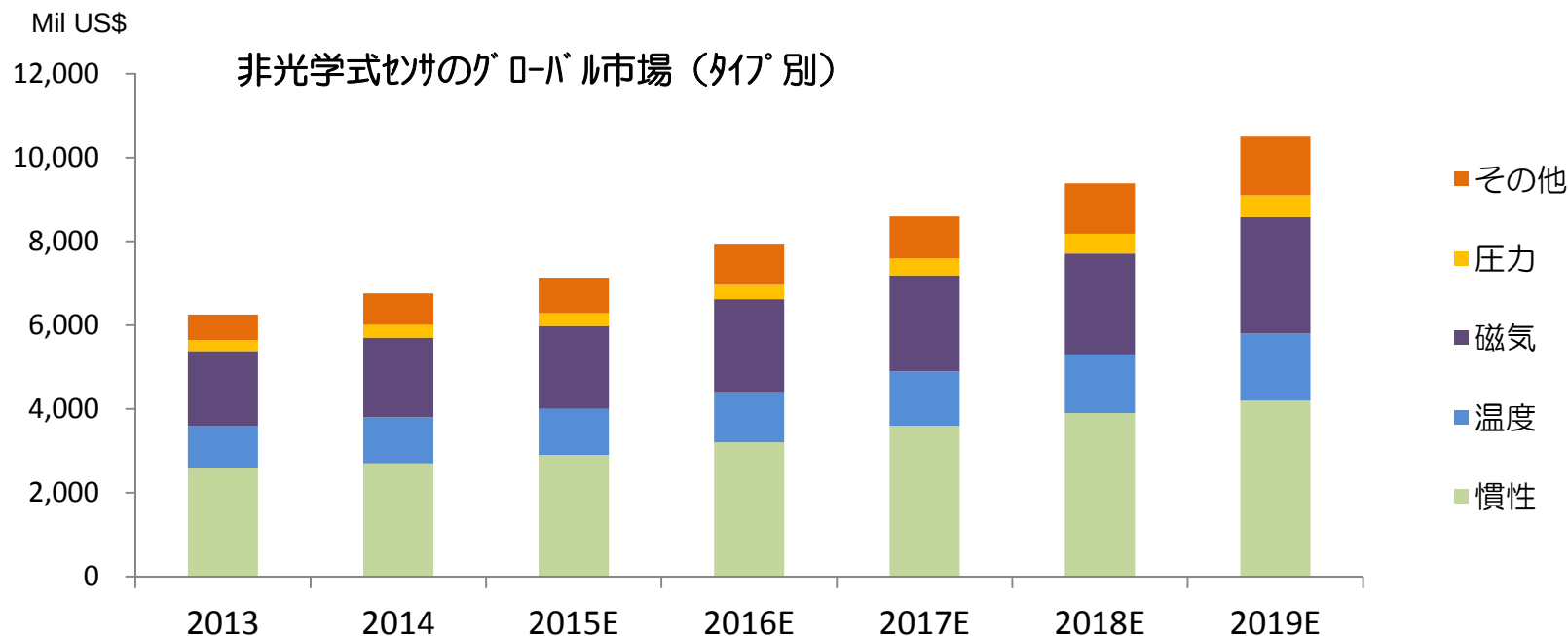
センサ・アクチュエーター

市場予測

非光学式センサ市場：
68億ドル／2014年⇒106億ドル／2019年



年率9.1%成長



(当社推定)

センサ・アクチュエーター

磁気センサ事業の拡大戦略

モジュール・センサシステムの事業拡大

- ・センサアッセンブリ技術の融合
- ・中国拠点を活用したローカルビジネスの拡大

Micronas社とのシナジー最大化

- ・ホール+TMRハイブリッド型車載向けセンサ
- ・ASIC/ASSP技術のTDK製品への展開

民生用途需要取込みによる事業拡大

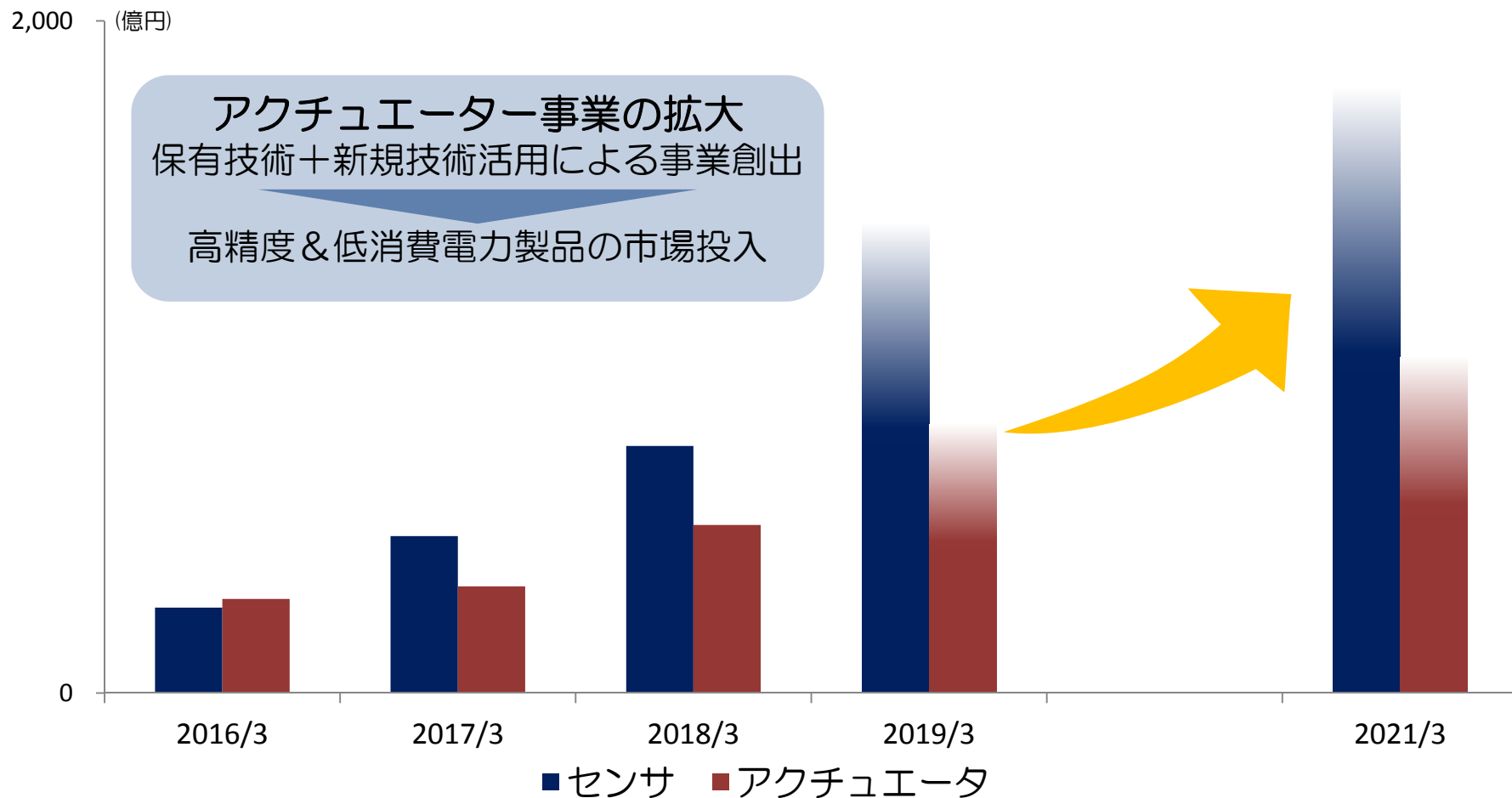
- ・高精度、省電力特性による新規需要の拡大

車載向けTMRセンサの事業拡大

- ・主要製品ラインアップの開発完了（17/3期）
- ・アプリケーション、顧客基盤の拡大

センサ・アクチュエーター

センサ及びアクチュエータ事業の拡大（売上）



エネルギーユニット

“単品からシステムへ”

電力変換機能、蓄電機能、エネルギー制御機能を持つ
ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたユニットを提供

電力変換機能

- AC-DC & DC-DCコンバータ
- インバータ
- チャージャー
- 回生エネルギー用双方向 AC-DC & DC-DCコンバータ
- 非接触給電

蓄電機能

- 産機用リチウムイオン電池
- 車載用リチウムイオン電池
- ESS (Energy Storage System)用リチウムイオン電池
- EDLC (電気二重層コンデンサ)

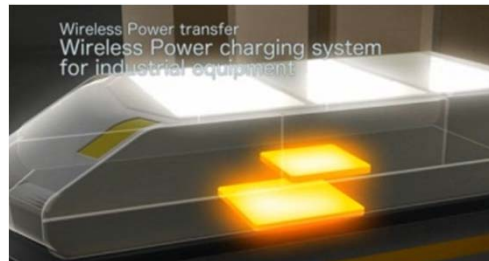
エネルギー制御機能

- BMU (Battery Management Unit)
- BMS (Battery Management System)
- 各種センサ (電流センサ、温度センサ等)

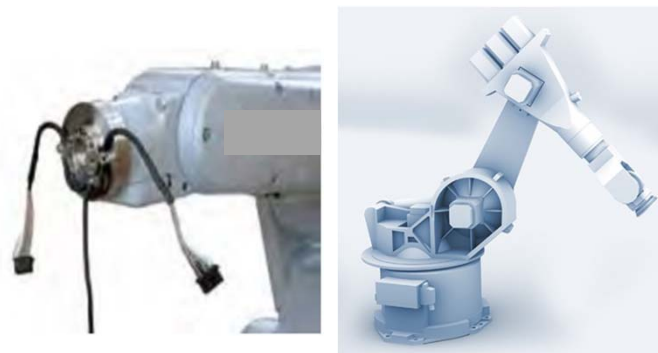
エネルギーユニット



AGV(Auto Guided Vehicle)



Mobile Robot



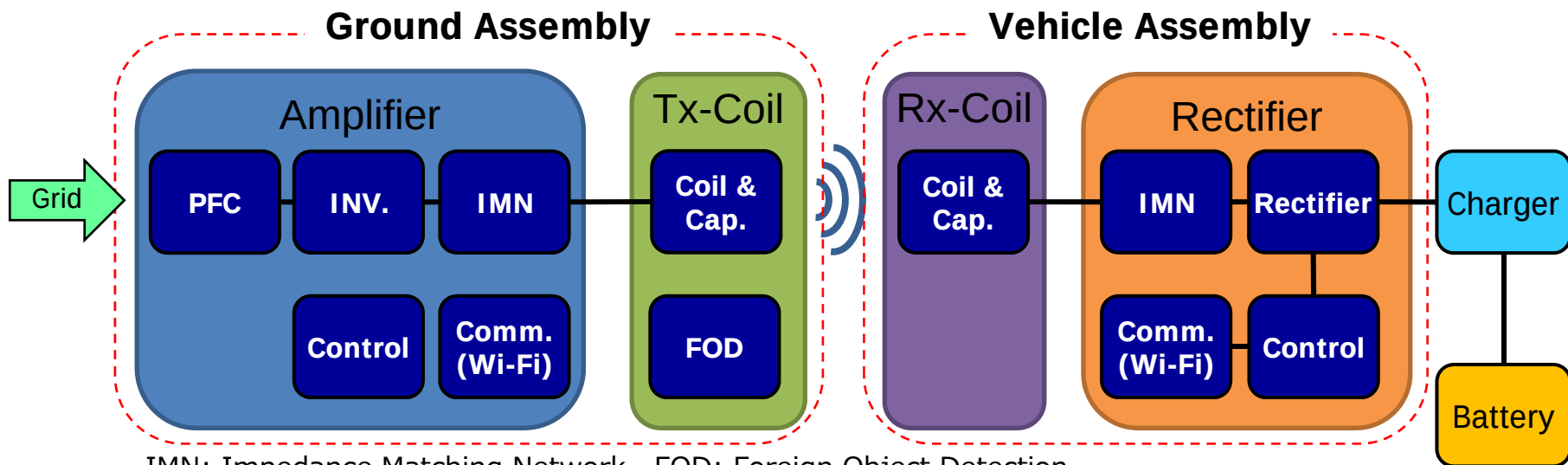
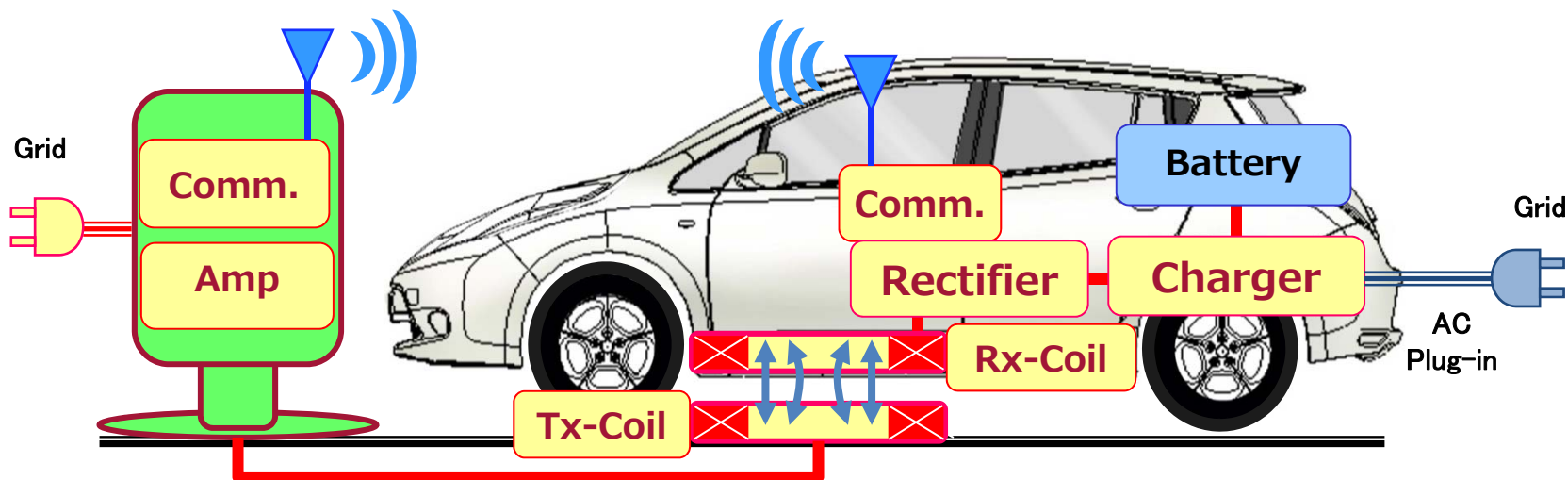
Hand of Robot



Pendant
for CNC

エネルギーユニット

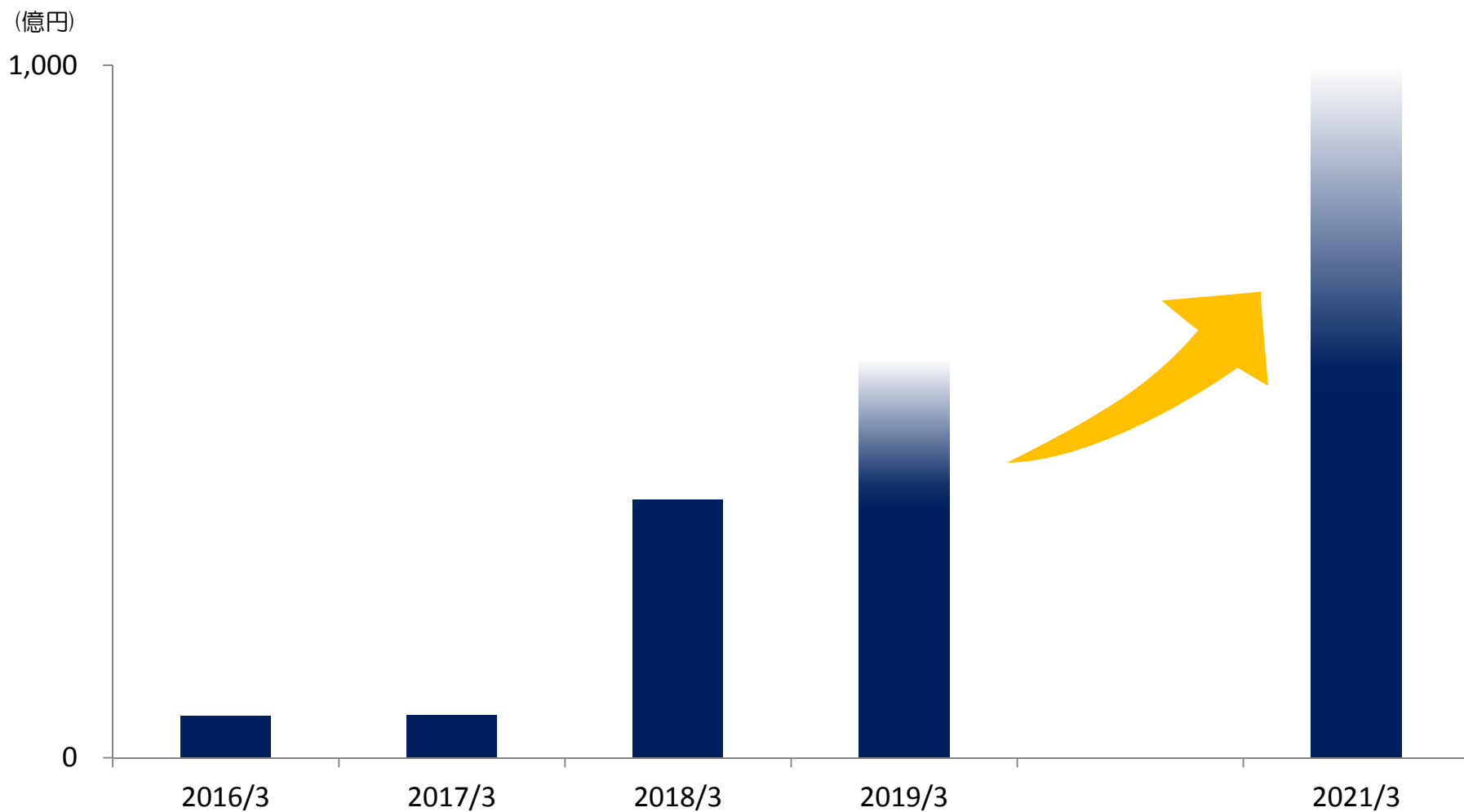
WPT System - Overview & Functions



IMN: Impedance Matching Network, FOD: Foreign Object Detection

エネルギーユニット

エネルギーユニット事業の拡大（売上）



次世代電子部品

『SESUB技術』 ・ 『薄膜技術』 ・ 『材料技術』 を融合させ、
今後多様化する顧客ニーズに応える 高付加価値製品を提供する

SESUB技術

薄膜技術

材料技術

次世代電子部品

- SESUB
- 複合部品
- 薄膜高周波フィルタ
- 薄膜コンデンサ（シート・個品）
- MEMS
- 低背インダクタetc.

次世代電子部品

最先端技術を導入し製品ライナップを拡大
受動部品内蔵のSESUBで更なる薄型パッケージを実現

SESUB

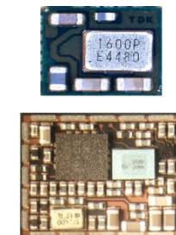
パワー系

μ DC/DCコンバータ
エンベロープトラッカー
LiBチャージャー



通信系

BLEモジュール
WiFiモジュール
PA/RFモジュール



薄膜デバイス

パワー系
通信系
センサ系
ノイズ系
CPU

薄膜コンデンサ
低背インダクタ
高周波フィルタ
薄膜コモンモードフィルタ
MEMSマイクロフォン
埋め込み型コンデンサ



ASE社とのJVを最大活用し、SESUBビジネスを本格拡大

次世代電子部品

ルネサスセミコンダクタ マニファクチャリング鶴岡工場の買収

合意の背景

- 秋田地区での薄膜受動部品製造拠点の構築
- 薄膜製品製造技術力の確保
- 将来の拡大に向けた生産スペースの確保

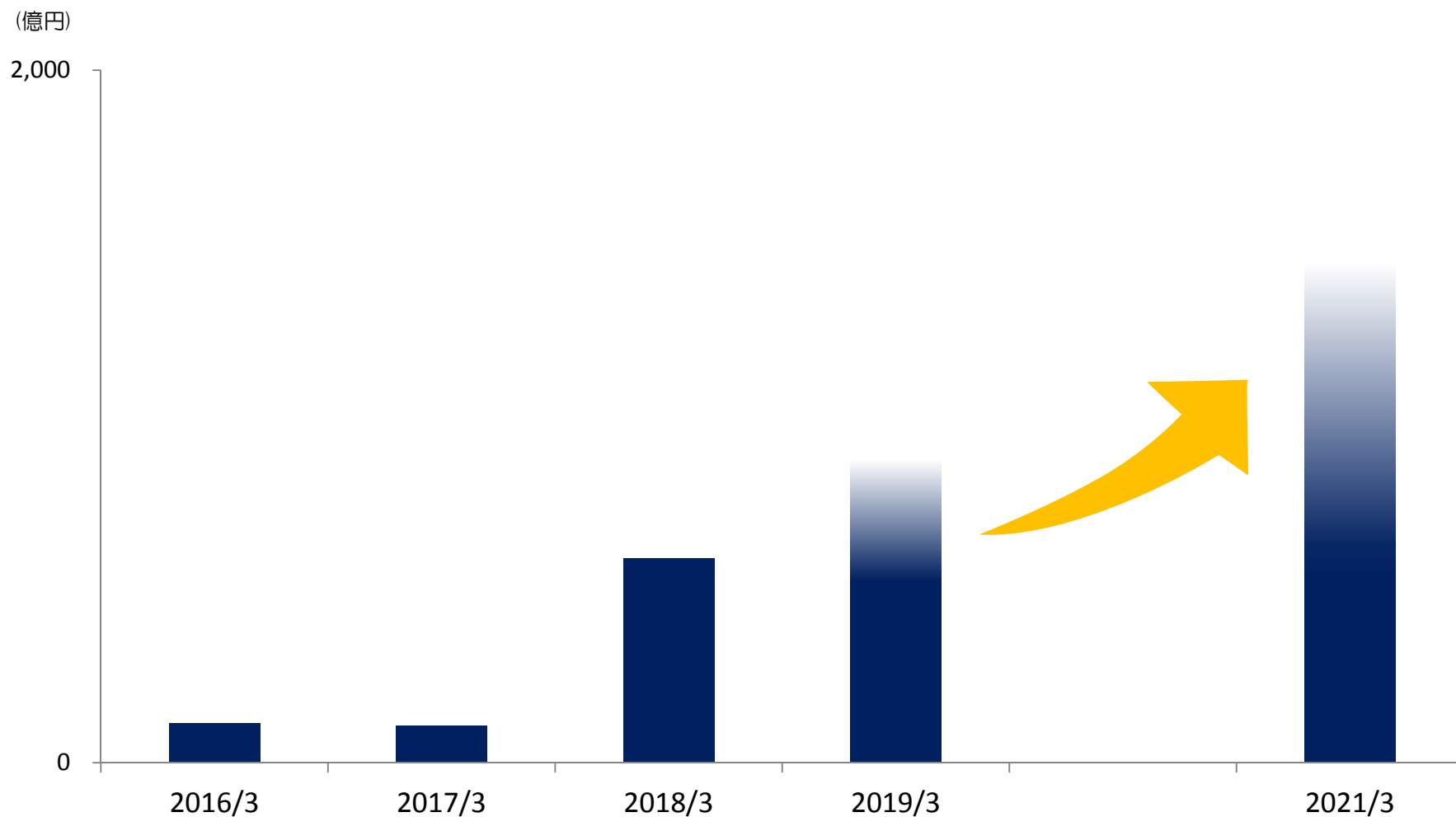
鶴岡工場 空撮



※ ルネサス セミコンダクタ
マニファクチャリング (株) 様資料より

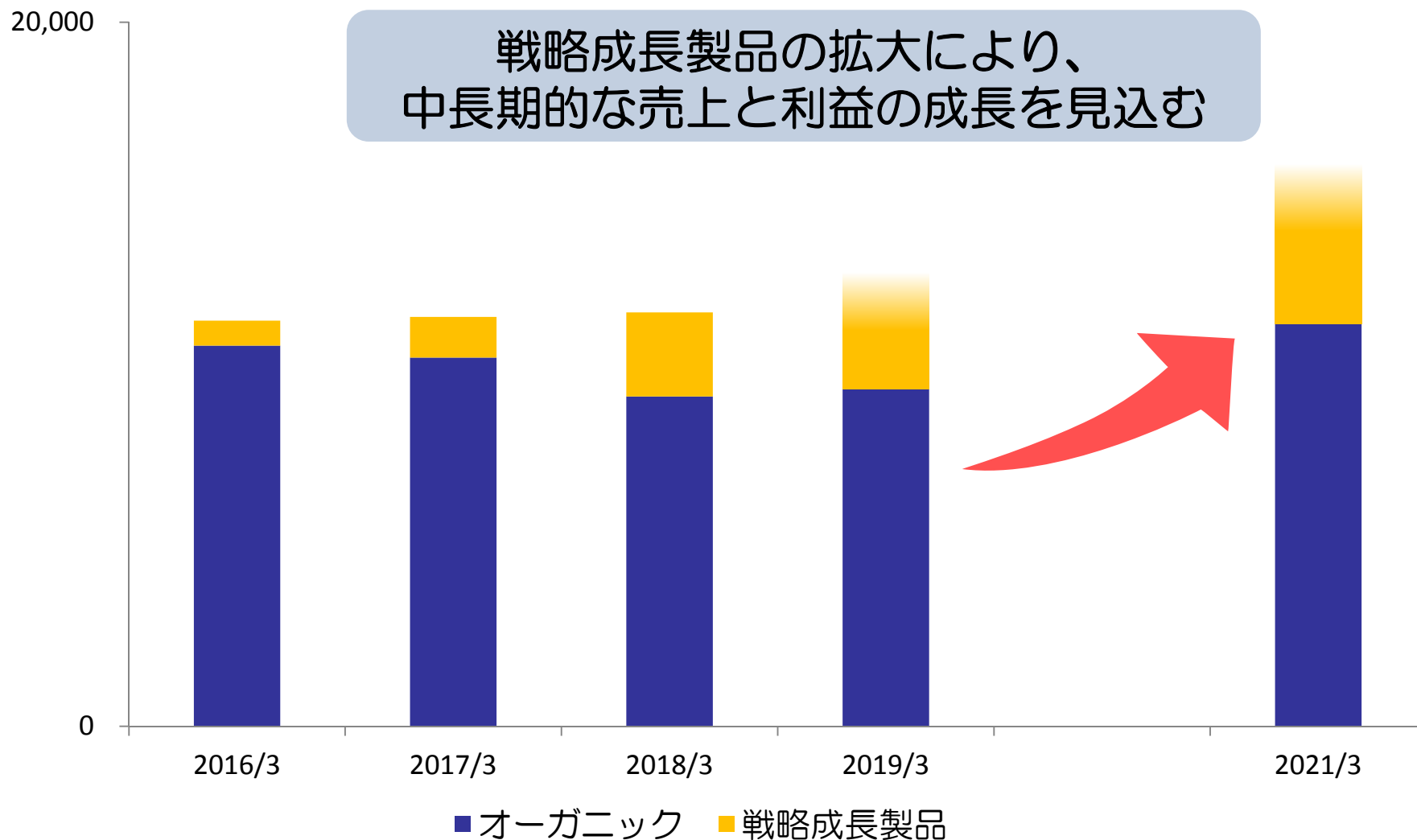
次世代電子部品

次世代電子部品事業の拡大（売上）



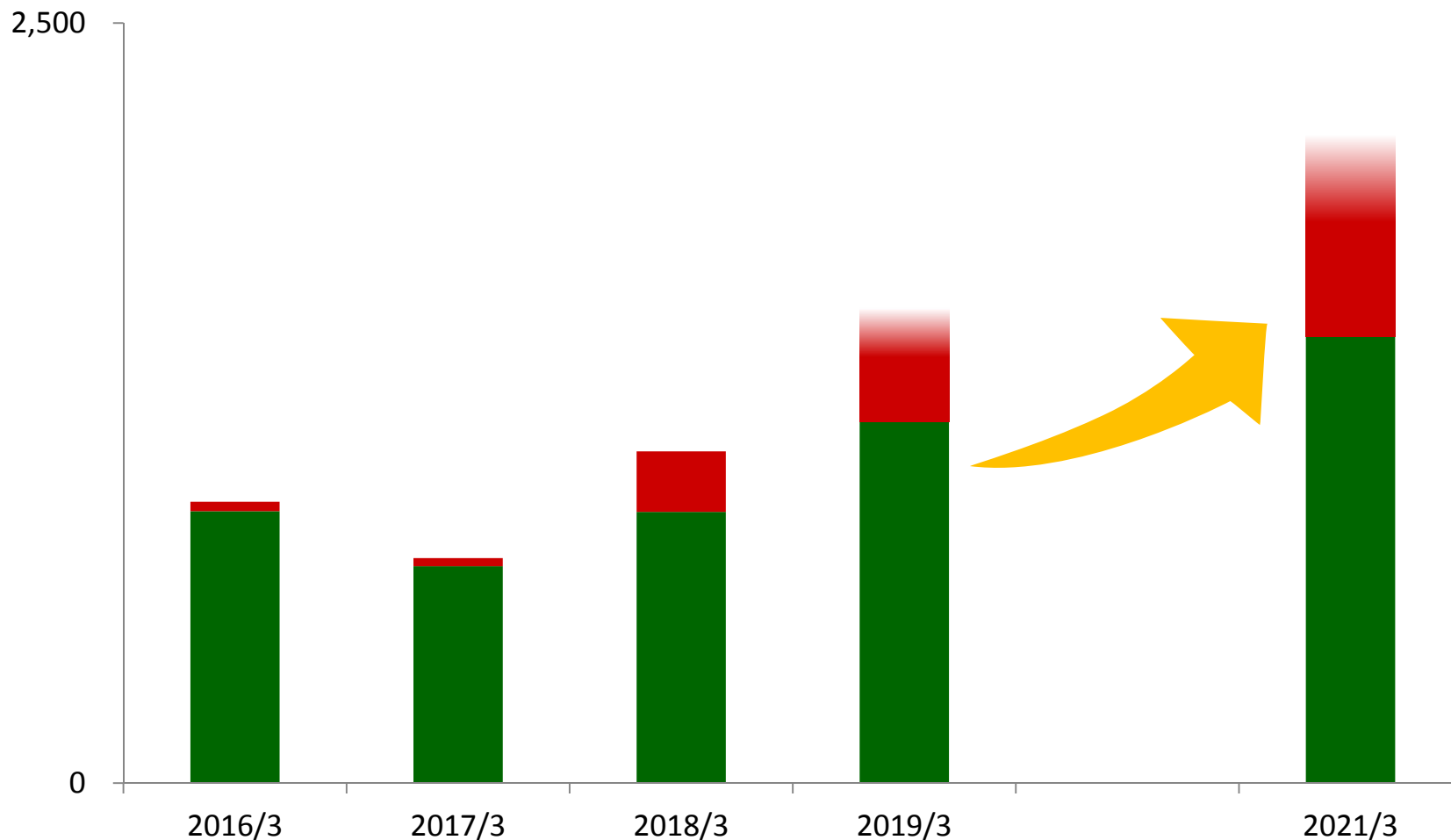
全社 売上見通し

(億円)



全社 営業利益見通し

(億円)



■ オーガニック ■ 戦略成長製品

中期経営目標

成長投資

- ・新製品、新規事業への投資、M&A
- ・既存事業の生産能力増強

株主還元

- ・EPS成長を通じ安定配当、増配
- ・配当性向30%目標



	2015年3月期実績	2018年3月期目標
営業利益率	6.7%	10%以上
ROE	7.2%	10%以上

成長投資

中計期間の総投資額
(16/3-18/3期)

設備投資

- 戦略成長製品の拡大加速
- 既存重点事業の拡大加速

3,500~4,000億円



4,300~4,800億円

R&D投資

- 海外R&Dの拠点強化
- ものづくり改革の加速

約2,300億円



約2,500億円

中期計画（オリジナル）

最新見込み

将来に関する記述についての注意事項

この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるものです。従って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、TDKグループの将来の実績、経営成績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なったものとなる恐れもあります。また、TDKグループはこの資料を発行した後は、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。

TDKグループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス市場は常に急激な変化に晒されています。TDKグループに重大な影響を与え得る上記のリスク、不確実性、その他の要因の例として、技術の進化、需要、価格、金利、為替の変動、経済環境、競合条件の変化、法令の変更等があります。なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。

又、本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信及び補足資料を参照していただきますようお願いいたします。



決算説明会の質疑応答を含むテキスト情報は以下のページに後日掲載をいたします。
http://www.tdk.co.jp/ir/ir_events/conference/2016/4q_1.htm